

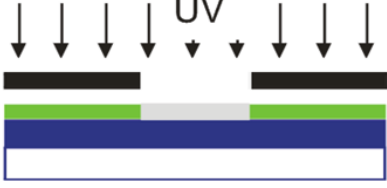



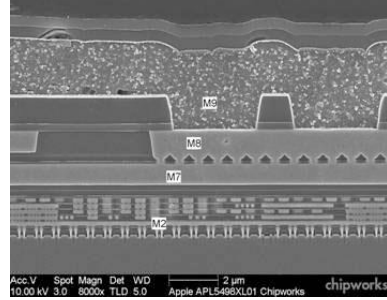


Typische Prozessschritte der nasschemischen Strukturierung

	<p>Wafer (Substrat) mit Funktionsschicht</p>
	<p>Fotolack aufbringen: Der Fotolack wird durch Rotation auf einem Drehteller auf die benötigte Dicke geschleudert</p>
	<p>Belichten: Der Lack wird an den belichteten Stellen chemisch verändert</p>
	<p>Entwickeln: mit der passenden Chemie kann der belichtete Fotolack entfernt werden</p>
	<p>Ätzen (nasschemisch): Eine auf das Funktionsmaterial abgestimmte Ätzlösung entfernt die freigelegten Flächen</p>
	<p>Fotolack entfernen: Zum Abschluss der Strukturierung wird der Fotolack entfernt.</p>
	<p>Mikroprozessoren werden Schicht für Schicht nach diesem Prinzip aufgebaut: Pro Ebene sind in der Regel drei Strukturierungen nötig: Funktionsschicht, Isolation, Metallschicht.</p> <p>Die Abbildung zeigt den Querschnitt durch einen Apple A5 Prozessor. Die 9 Ebenen benötigen also 27 Durchgänge des oben beschriebenen Prozesses. Der A5-Chip wurde im iPad2 und dem iPhone 4S verbaut.</p>